

证券代码：688603

证券简称：天承科技

上交所公告编号：2026-015

上海天承科技股份有限公司

关于召开十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 04 月 28 日（星期二）至 05 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 public@skychemcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日发布公司 2025 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-17:00 举行十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：童茂军先生

财务负责人：王晓花女士

独立董事：石建宾先生

首席技术官：韩佐晏先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 05 月 08 日（星期五）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 04 月 28 日（星期二）至 05 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 public@skychemcn.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：021-59766069

邮箱：public@skychemcn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司

2026年4月30日